



芝普企業股份有限公司 E-CHEM ENTERPRISE CORP.

May. 18, 2026

免責聲明

本簡報及本公司於同一時間發布之相關資料，包含歷史資訊以及管理階層對未來業務發展之預測性說明，係基於芝普企業股份有限公司（以下簡稱「本公司」）目前可得資訊與主、客觀判斷所作之評估。

本簡報中所揭露之未來展望，涉及未來事件與營運績效之預測，可能受到多項風險與不確定因素之影響，導致實際結果與預期產生重大差異。該等風險與因素可能包括但不限於產業景氣變動、國內外經濟狀況、市場競爭、原物料價格波動、法規變動、技術進展與其他非本公司可掌控之因素。

本公司不保證本簡報所載之資訊（包括對未來的展望）為最新、完整或無誤，並無義務就其內容之任何變動進行更新、修正或重新公告。

本簡報中所載之合併財務資訊如經會計師查核或核閱，將另行註明；若無註明，則為管理階層編製之自結數據，僅供參考之用。詳細財務資訊請參閱本公司公開發布之財報及相關查核報告。

本簡報內容僅供說明及參考之目的使用，未經本公司書面同意，任何第三人不得擅自引用、節錄、轉載或散布本簡報之全部或部分內容。

= 簡報大綱 CONTENTS



股票代號 7858

01

關於芝普
About E-Chem

02

產品及市場
Market & Products

03

未來發展
Future Plan

04

經營績效
Business Performance

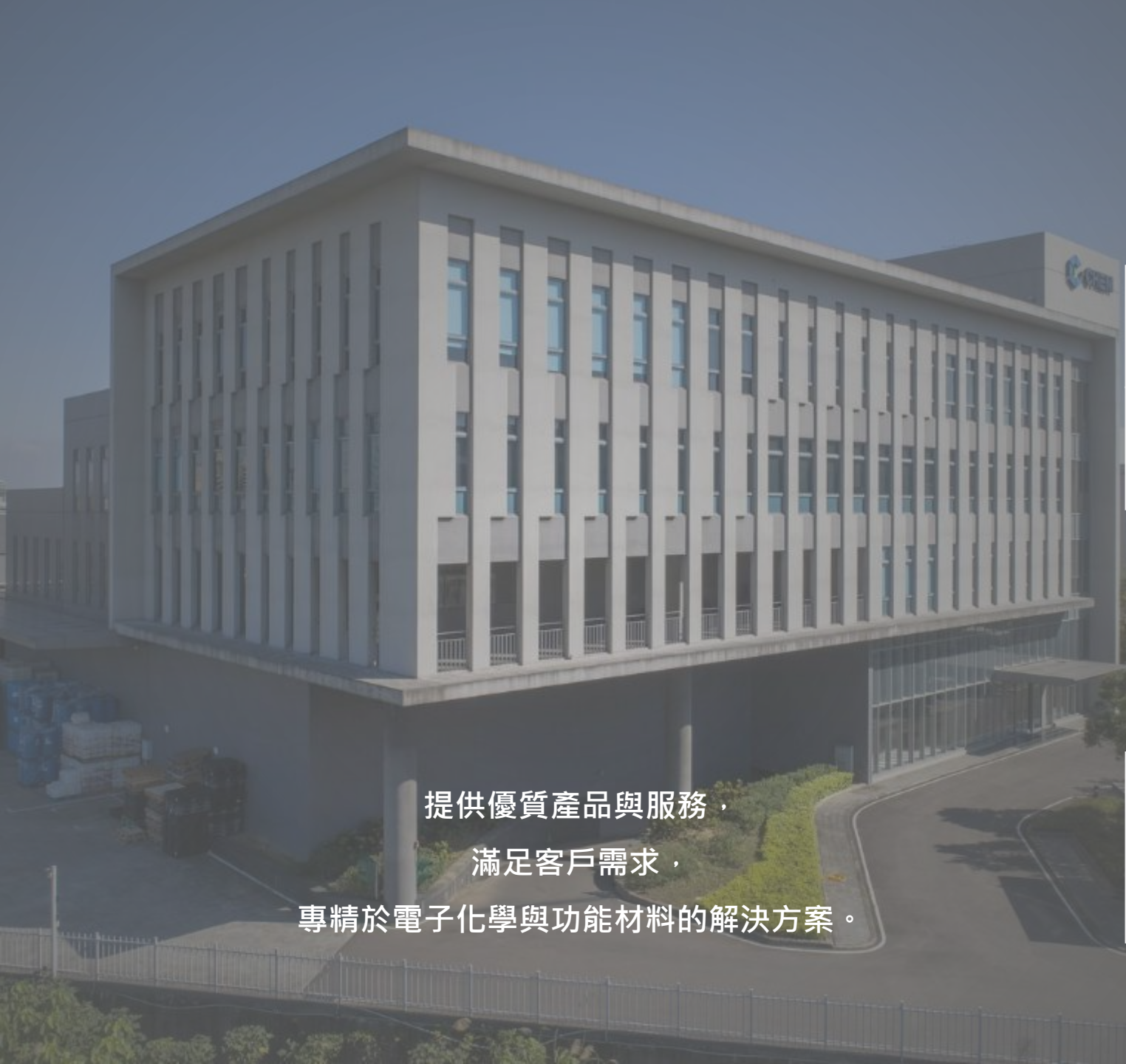


股票代號 7858

關於芝普

About E-Chem

01



提供優質產品與服務，
滿足客戶需求，
專精於電子化學與功能材料的解決方案。

About E-Chem



股票代號 7858

關於芝普企業

成立時間
1989 年

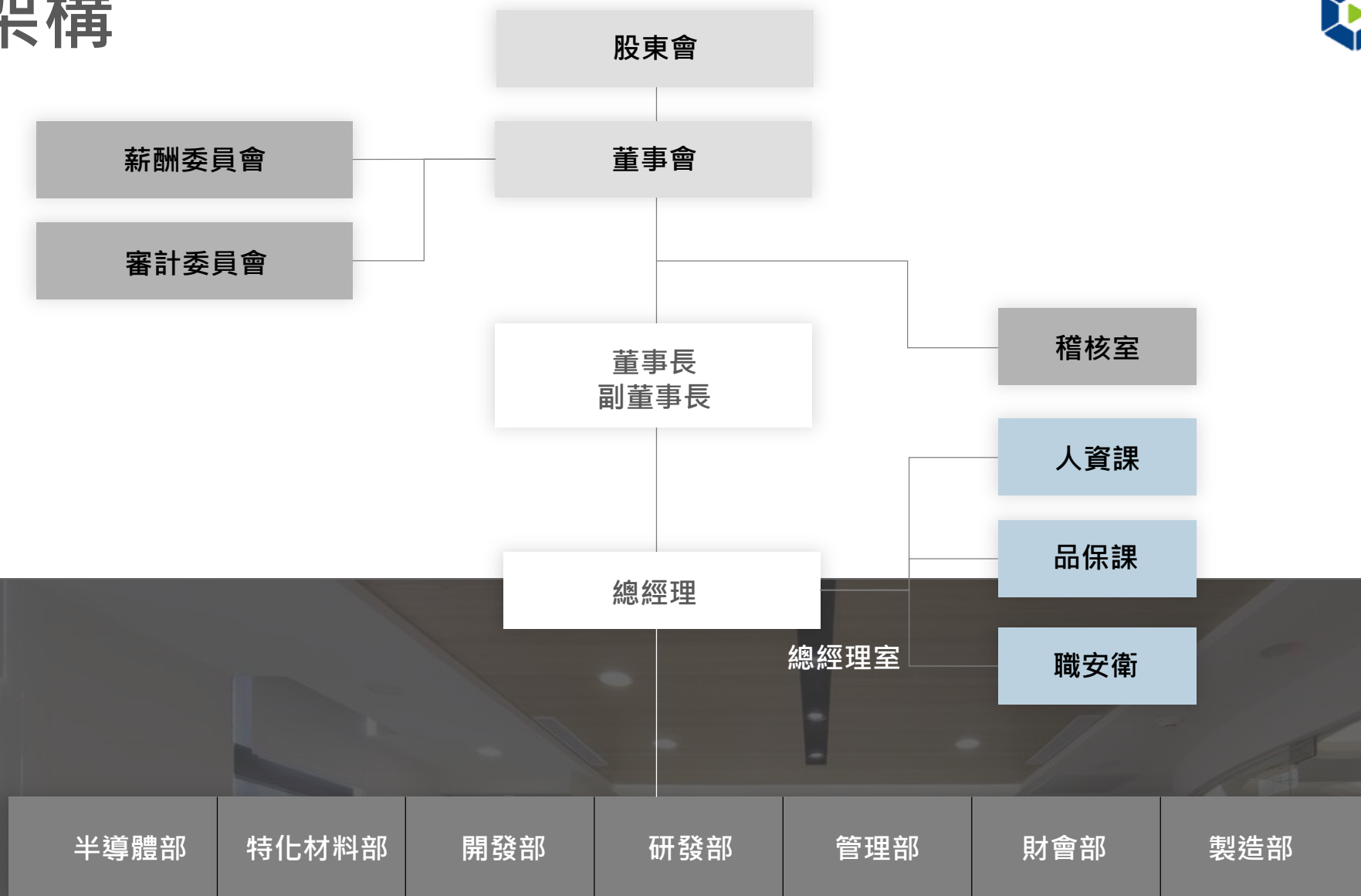
董事長
林士堯

員工人數
約108人(截至2026/04底)

資本額
2 億 2237 萬元

主要產品
半導體製程用化學品及材料 68%
特用化學品及材料 32%

組織架構





董事長 林士堯 (Lin Shih-yao)

核心經歷：

半導體先驅：

曾任聯電 (UMC) 資深蝕刻製程工程師，
為該公司當時最年輕的副廠長。

高階領導：

曾任欣興電子董事長資深特助兼任智慧產品總經理、恆顥科技
執行長、群創光電副總經理

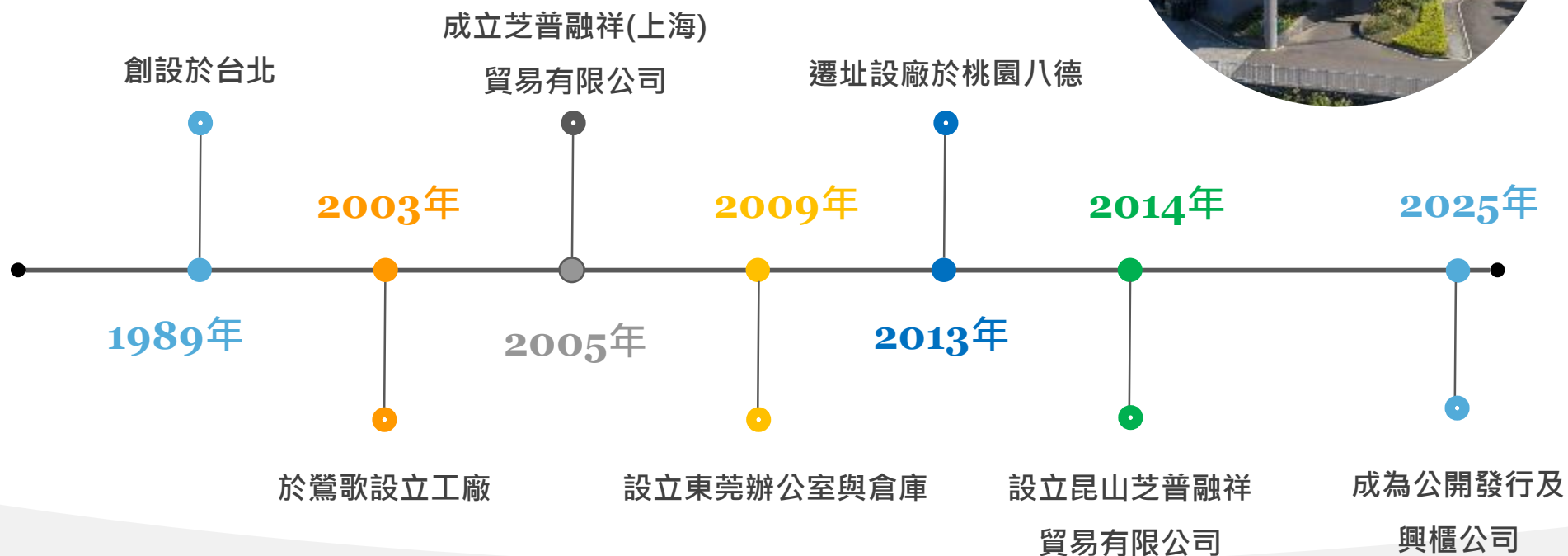
產業佈局：

擔任過台康科技董事長、
時緯科技執行長、明興光電執行長及統寶光電資深副總經理。

扎實投入研發資源，是我們對客戶與環境最誠實的承諾。



公司大事紀



立足台灣，深耕亞洲：全球營運佈局與市場擴展

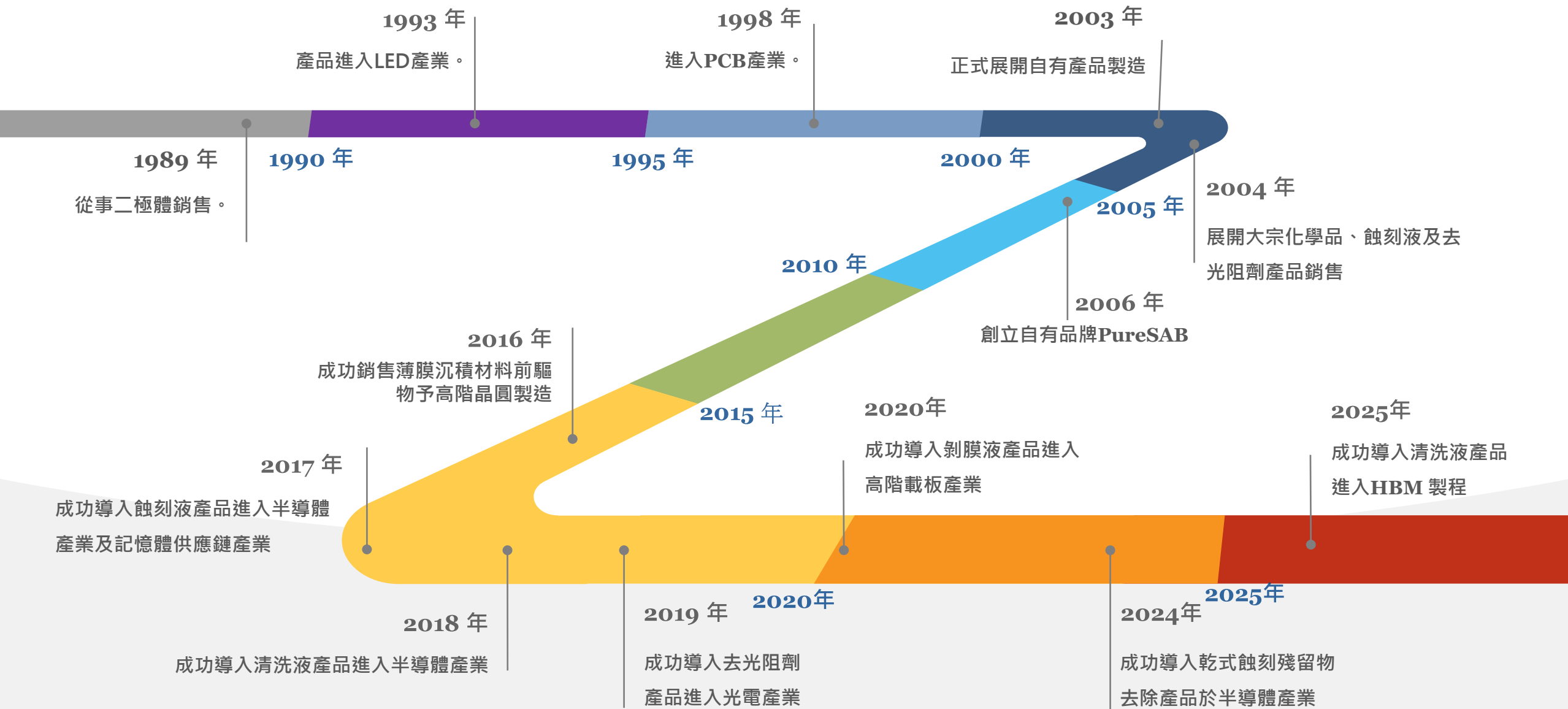


股票代號 7858

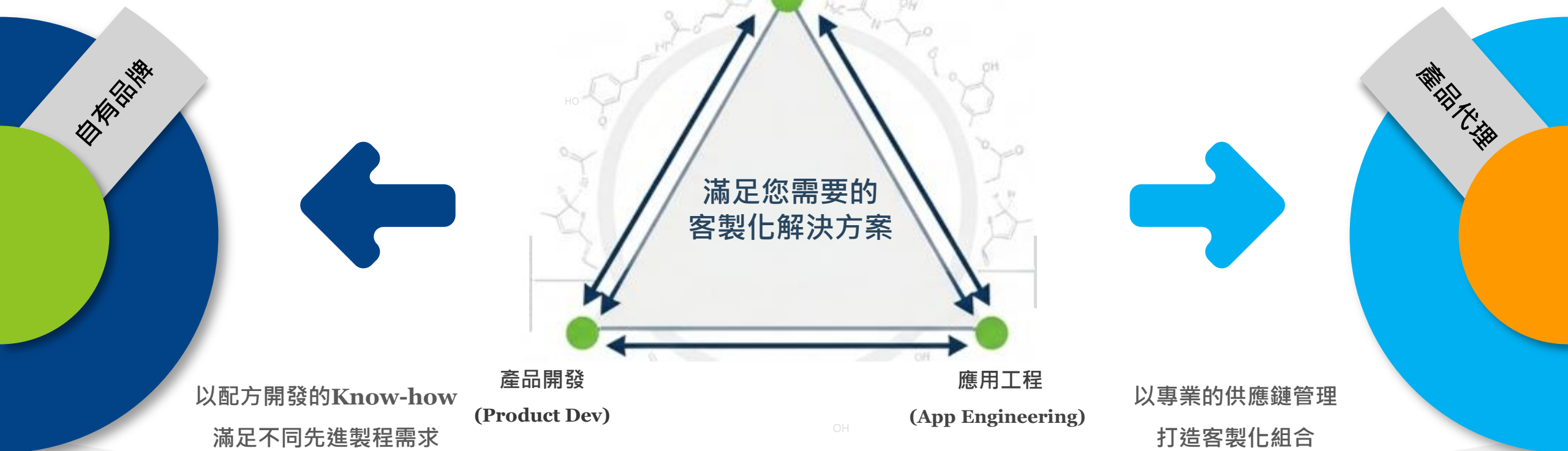


以客戶為中心：將卓越的電子化學品配方開發與技術支援，由台灣總部擴展至全亞洲，建置完善的在地供應鏈與快速響應服務。

發展沿革



核心能力與商業模式



聚焦高階製程與綠色產品發展，厚植客製化配方能力、滿足客戶先進製程需求。以提供最好的在地技術服務、快速供應鏈反應。

以安全與永續材料，驅動未來高階製造



股票代號 7858



【綠色材料·安心未來】

- 持續關注無毒、低危害與環境友善材料。
- 回應客戶對危害物質與產品安全要求。
- 朝高品質與永續應用方向發展。



【品質穩定·信賴同行】

- 深化ISO9001與品質管理文化
- 持續優化製程穩定與產品可靠性
- 強化供應鏈韌性，創造永續價值鏈



【誠信治理·永續經營】

- 強化公司治理與法規遵循
- 導入數位化風險管理，創造穩定長期價值
- 因應氣候變遷趨勢，推動低碳永續轉型



【安全職場·共好成長】

- 落實ISO14001、ISO45001管理制度
- 重視人才與健康職場環境，持續推動6S管理法
- 以人為本，打造幸福友善職場

產品與市場

Market Information

＝ 打造專業化學材料平臺

- 高純度化學品
- 前驅物
- 電子級/工業級化學品

製程用
化學品

特用
化學品

貴金屬
化學品

表面處理
化學品

- 蝕刻
- 去光阻
- 清洗
- 電鍍/無電鍍

產品平臺

主要客戶領域

其他產業

半導體

二極體

晶圓代工

化合物半導體

記憶體

封裝

微機電

LED/MINI LED

特用化學

配方藥水商

高階載板

被動元件

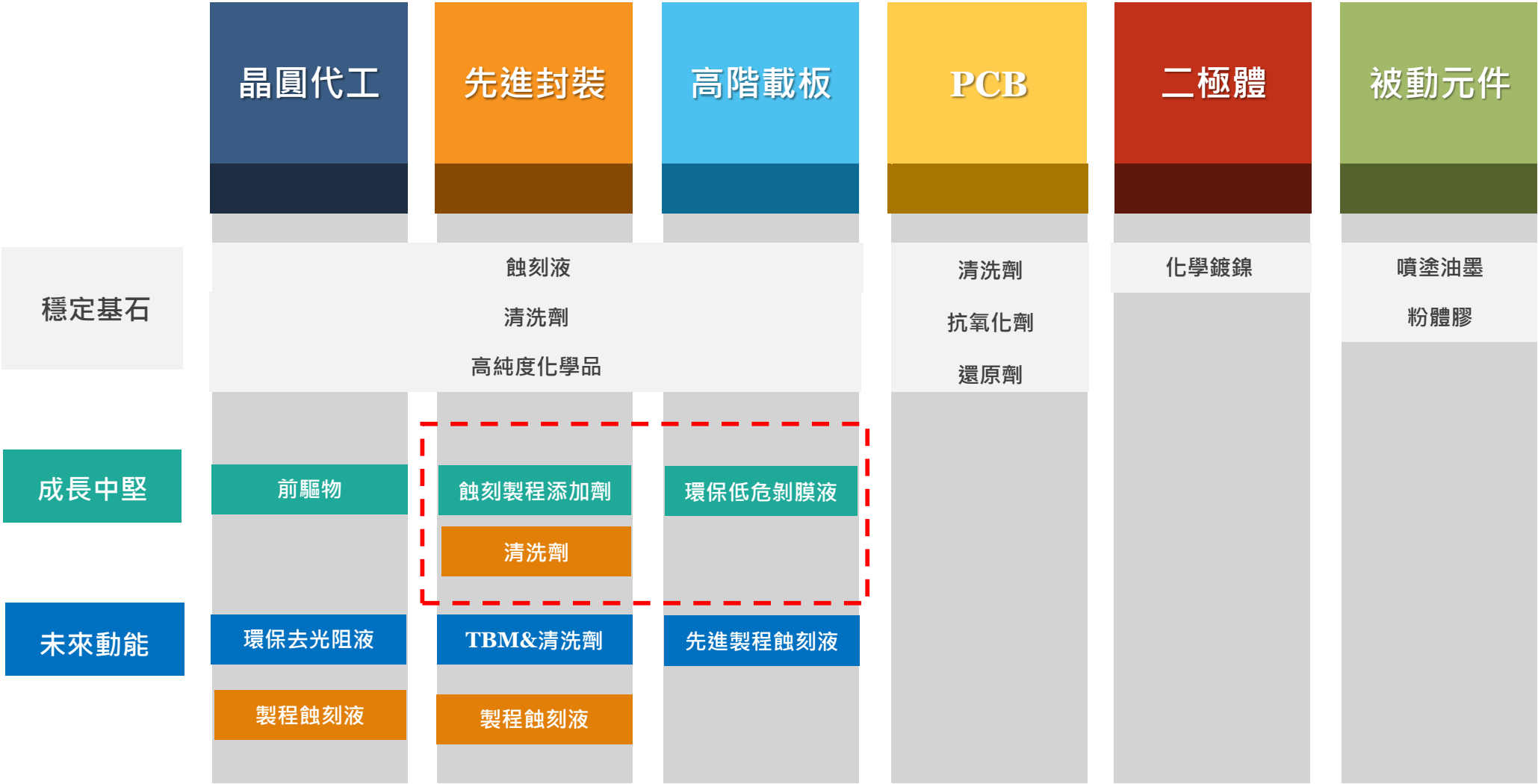
新能源

熱管理

軟板

生技

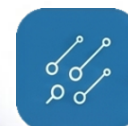
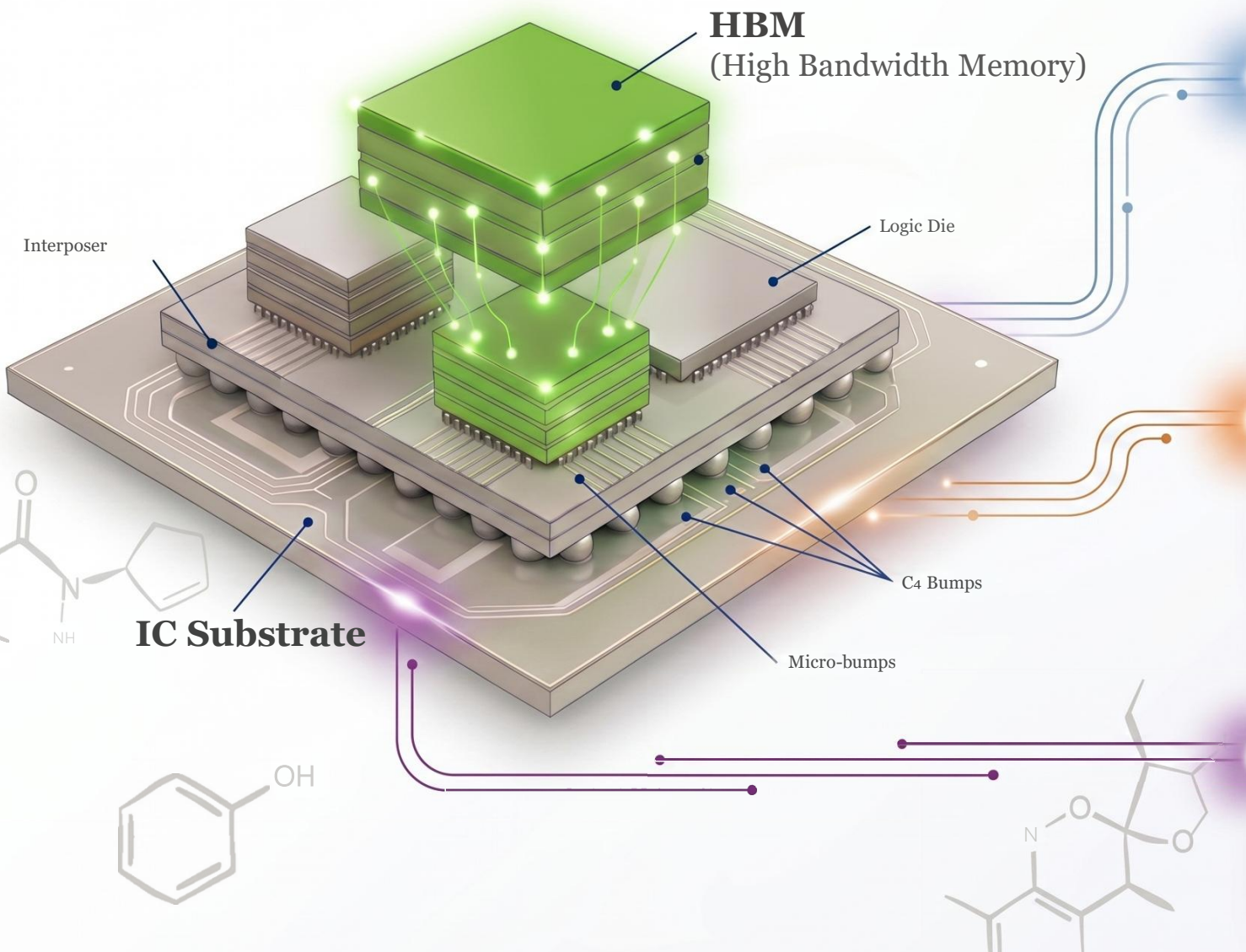
產品銷售及布局



高性能半導體材料技術突破

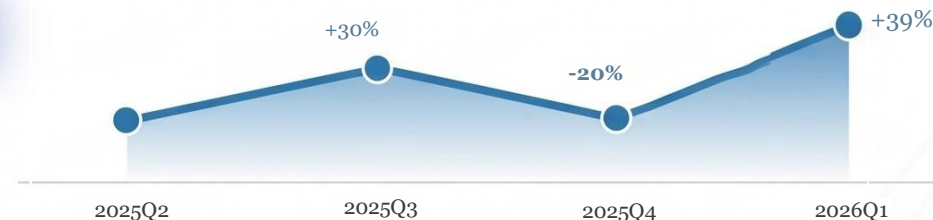


股票代號 7858



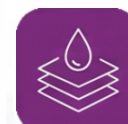
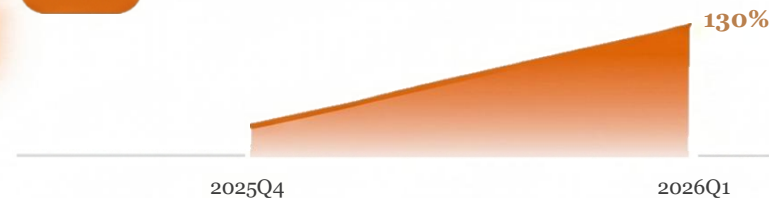
高性能HBM蝕刻添加劑

高性能HBM製程關鍵材料，產能顯著提升 **39%**



先進清洗劑市場增長

市場領先，全製程穩定增長 **+130%**



環保剝膜液製程優化

精細IC基板良率穩定提升 **22%**

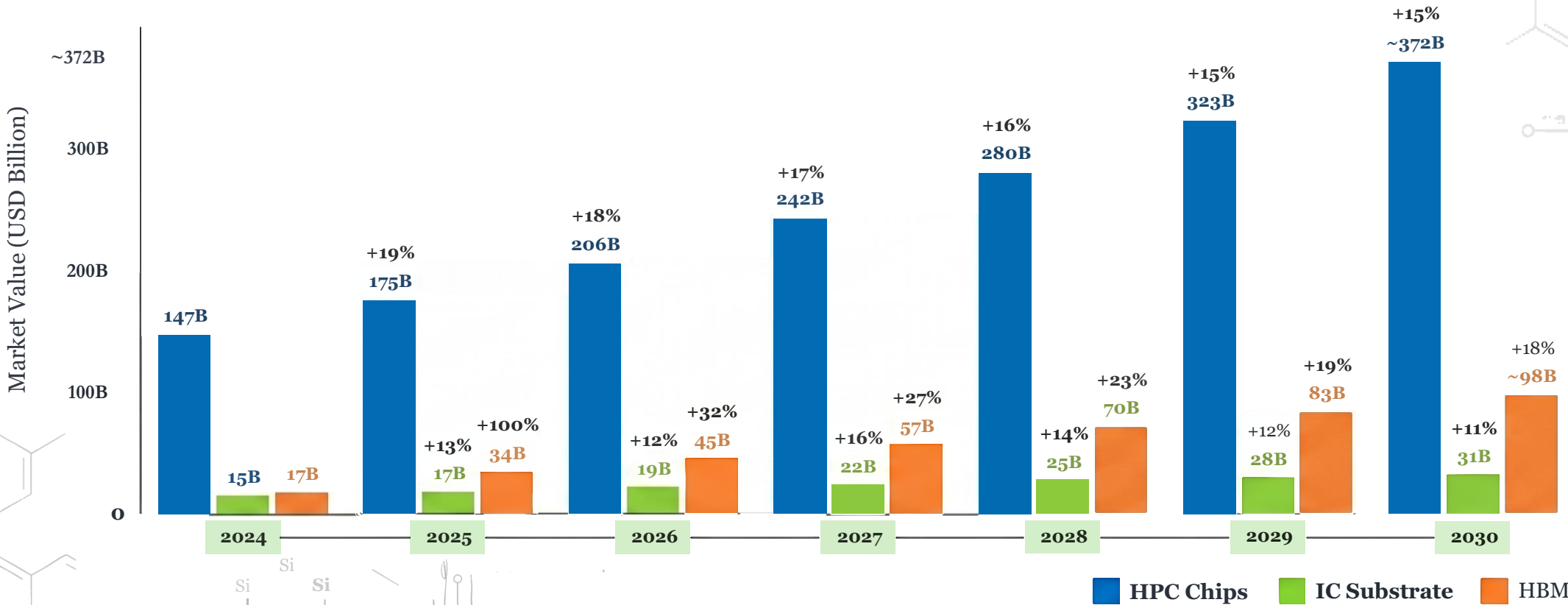


未來發展

Future Plan

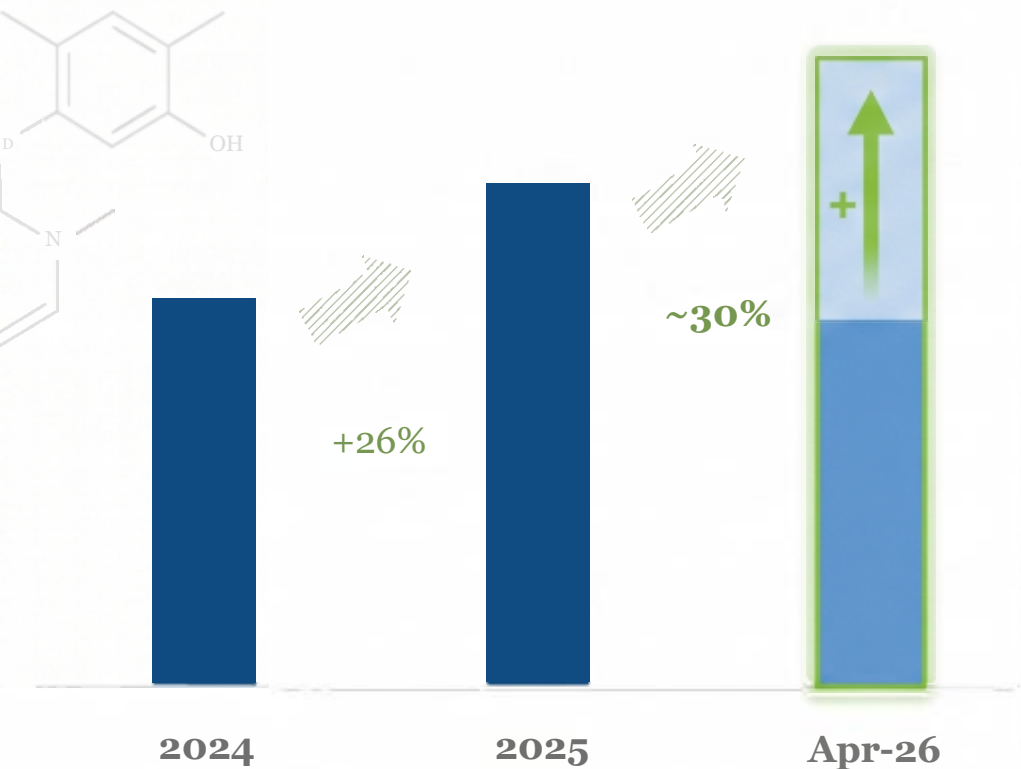
市場發展趨勢與產業需求

AI Ecosystem: Core Hardware Market Forecast (2024-2030)



Source: Yole Group, compiled by E-CHEM

研發項目持續成長



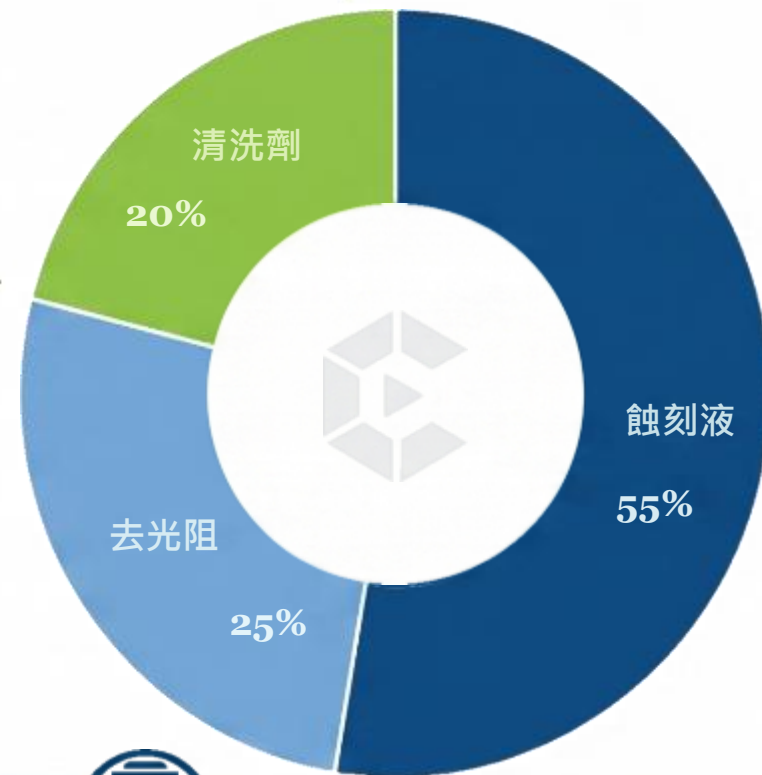
研發項目數持續成長

- 2025年研發項目數較2024年成長26%
- 2026年Q1新接項目數已達2025年2/3
- 2026 研發項目數預計成長約30%



清洗劑開發優勢

- 常溫快速清洗，無殘留
- 洗髒污不傷結構
- 去除時間短且環保



環保去光阻剝膜液已完成認證

- LDI乾膜
- LS5/5細線路
- 抗鍍金乾膜



蝕刻液技術重點

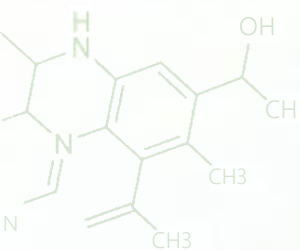
- 高蝕刻選擇比與低側蝕
- 環保安全配方
- 無氣味且高品質



未來發展



股票代號 7858



厚植核心能力

加大研發投入及人才培養
建構並強化產品競爭力

優化製程產能

優化製程與生產能力
拓展新業務模式，釋放新廠潛能

關注新興產業

關注高成長潛力材料需求
拓展新興市場新機會

深化全球佈局

深化東南亞、韓國與中國業務
善用既有供應鏈優勢，拓展全球佈局



經營績效

Business Performance

二 營收與獲利

(單位：仟元)

	111年	112年	113年	114年
營業收入	1,436,376	1,156,095	1,519,950	1,509,079
營業成本	1,103,544	896,902	1,181,635	1,158,147
營業毛利	332,832	259,193	338,315	350,932
毛利率	23.17	22.42	22.26	23.25
營業費用	261,698	250,917	266,211	277,073
營業淨利	71,134	8,276	72,104	73,859
稅前淨利 (損)	74,084	17,277	78,911	70,589
本年度淨利	58,635	10,823	63,930	57,146

本資料由 (興樞公司)芝普 公司提供

民國115年04月

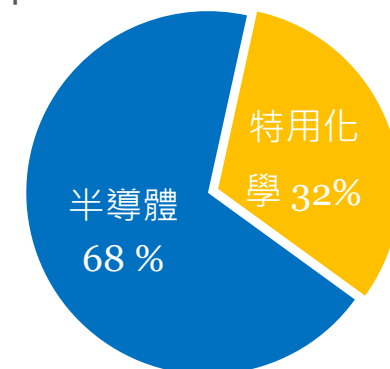
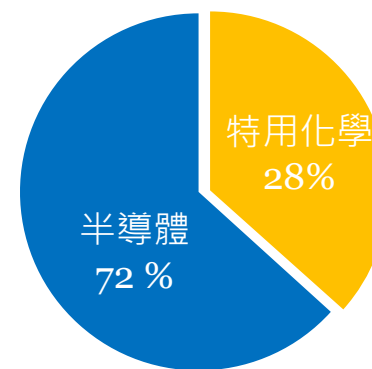
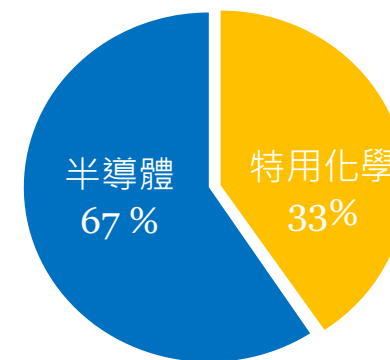
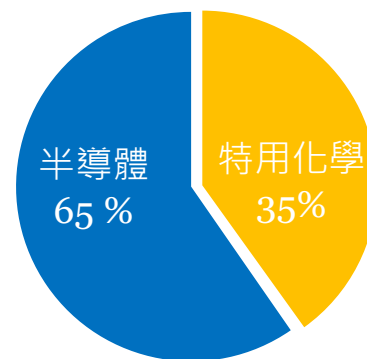
單位：新台幣仟元

項目	營業收入淨額
本月	182,087
去年同期	113,273
增減金額	68,814
增減百分比	60.75
本年累計	672,386
去年累計	461,189
增減金額	211,197
增減百分比	45.79

營收與部門別資訊

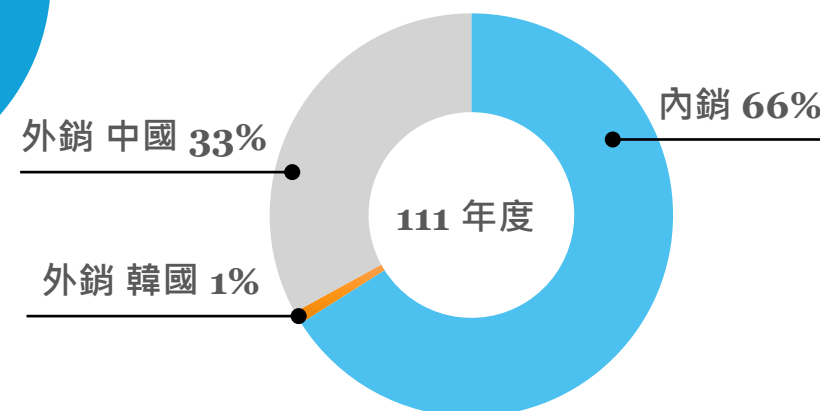
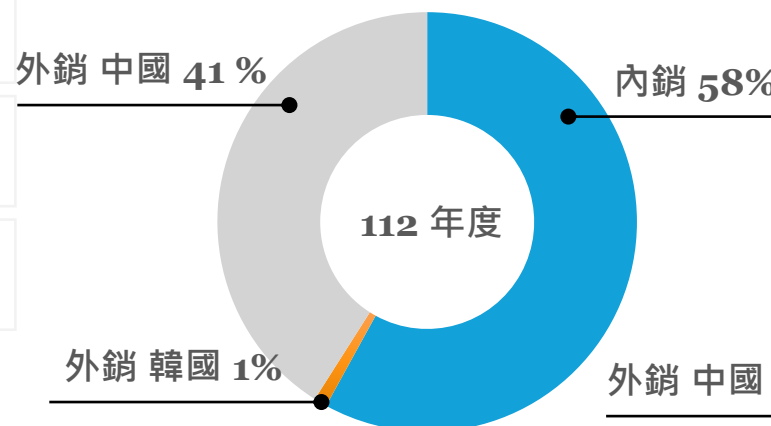
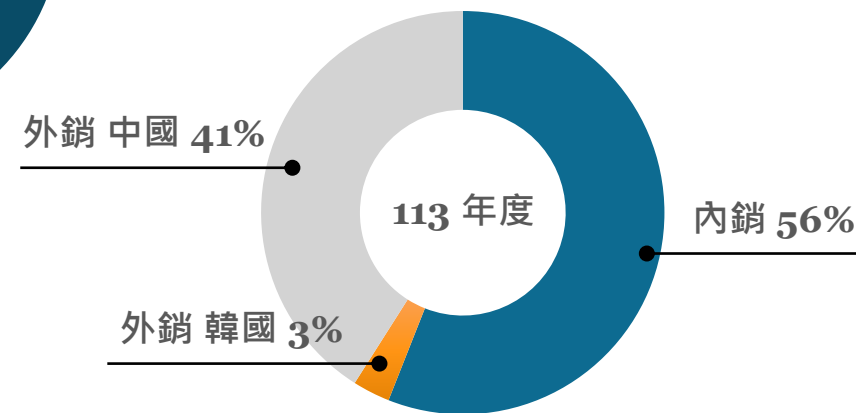
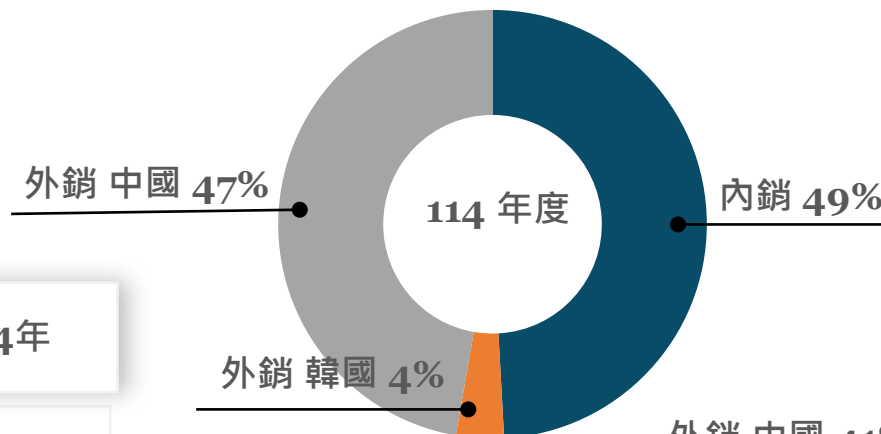
(單位：仟元)

	111年	112年	113年	114年
營業收入	1,436,376	1,156,095	1,519,950	1,509,079
營業成本	1,103,544	896,902	1,181,635	1,158,147
營業毛利	332,832	259,193	338,315	350,932
毛利率	23.17	22.42	22.26	23.25
營業費用	261,698	250,917	266,211	277,073
營業淨利	71,134	8,276	72,104	73,859
稅前淨利 (損)	74,084	17,277	78,911	70,589
本年度淨利	58,635	10,823	63,930	57,146



＝ 內外銷資訊及占比

	111年	112年	113年	114年
內銷	949,190	674,430	857,543	738,711
外銷	487,186	481,665	662,407	770,368
中國	473,371	468,209	615,466	710,552
韓國	13,300	12,870	46,129	54,171
其他	515	586	812	5,645



＝ 股利發放政策

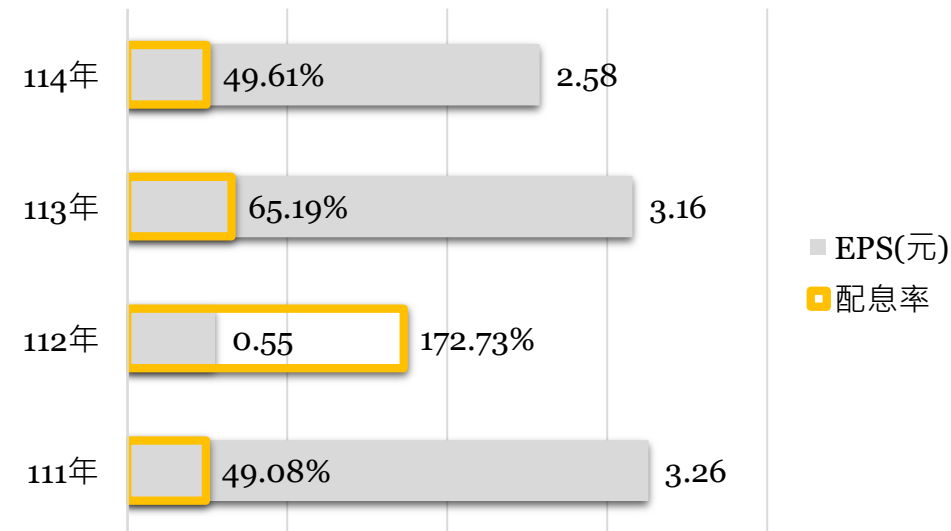


股票代號 7858

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘、股利為新台幣元外)

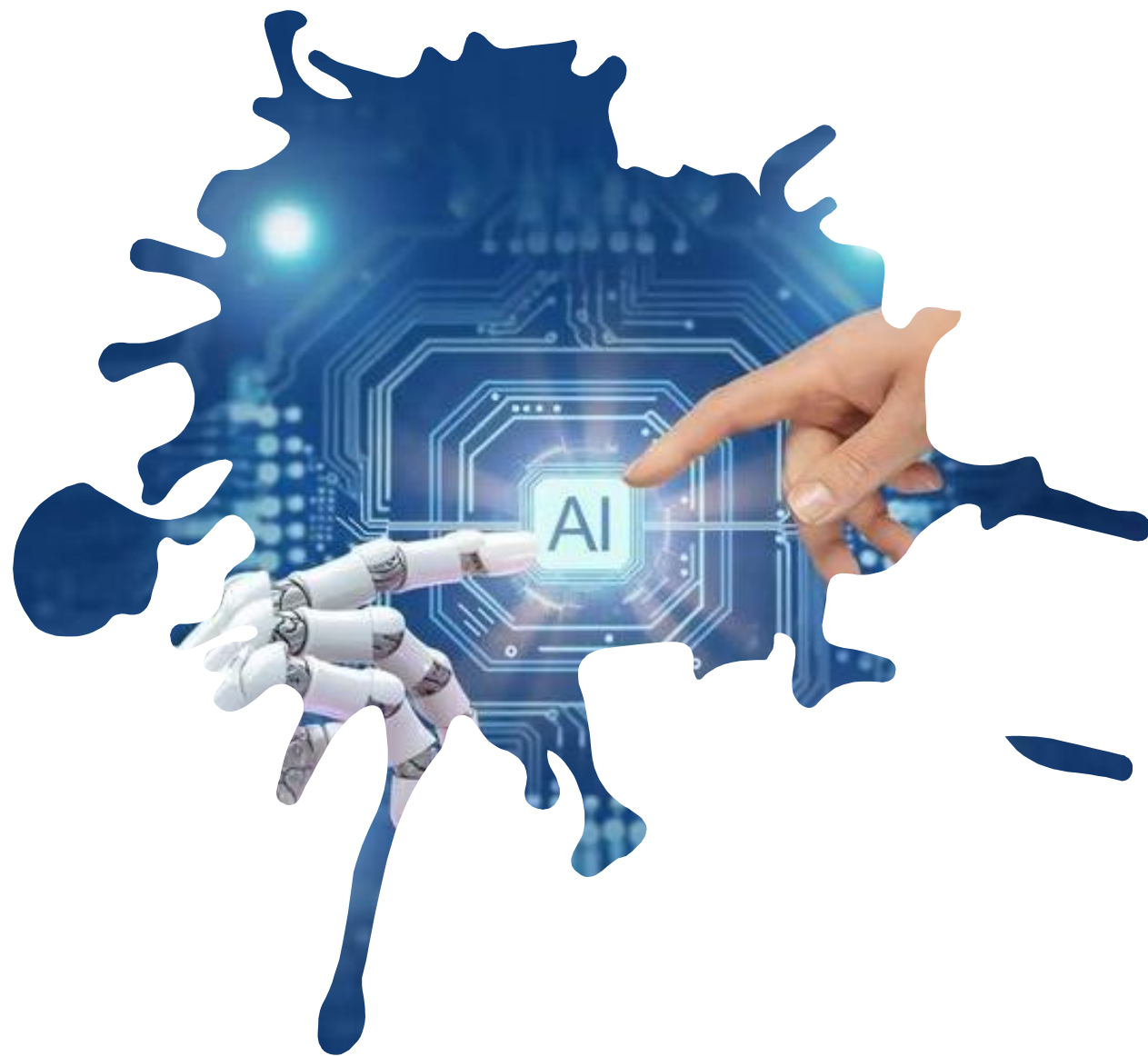
	111年	112年	113年	114年
本年度淨利	58,635	10,823	63,930	57,146
股本	179,998	179,998	206,987	222,370
EPS(元)	3.26	0.55	3.16	2.58
現金股利	1.60	0.45	1.41	1.28
股票股利				
資本公積轉增資	0.00	0.50	0.00	0.00
盈餘轉增資	0.00	0.50	0.65	0.00
配息率	49.08%	172.73%	65.19%	49.61%

不含公積轉增資



本公司股利政策

1. 就當年度未分配盈餘提撥**不低於百分之二十**
分配股東股息及紅利
2. 分配股東股息及紅利時得以現金或股票方式為之，其中**現金股利不低於股利總額的百分之三十**



=

Q & A



股票代號 7858

Thanks